

Product Overview

SK-AM62B 设计包文件夹和文件列表

表 1 列出了 SK-AM62B 中包含的文件夹名称、文件夹中的文件名称以及所有文件的格式。AM62B 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 是基于 AM62x 片上系统 (SoC) 构建的独立测试和开发平台。AM62x 处理器包含一个四核 64 位 Arm®-Cortex®-A53 微处理器、一个单核 Arm Cortex-R5F 微处理器 (MCU) 和一个 Arm Cortex-M4F MCU。产品概述文档位于 TI.com 上的 SK-AM62B 产品文件夹中，供客户在下载单个 Zip 文件夹之前查看。

表 1. Proc114A1

| 文件夹 (第 1 级) | 文件夹 (第 2 级) | 所含文件 | 文件类型 |
|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------|
| ---- | ---- | PROC114A1_Folders_Files_List | XLS |
| | | 2024 年重要声明 | PDF |
| 1_SCHEMATIC | PDF | PROC114A1(001)_Sch_With_Design_Updates..Notes_V1.0 | PDF |
| | PDF -Backup_SK_Schematic | PROC114A1(001)_sch | PDF |
| | ---- | Schematic_Revision_Readme | PDF |
| | ORCAD | PROC114A1(001)_Sch_With_Design_Updates..Notes_V1.0 | DSN |
| | ORCAD - Backup_SK_Schematic | PROC114A1_SCH | DSN |
| 2_BOM | ---- | PROC114A1(001)_BOM_With_Design_Updates..Notes_V1.0 | XLS |
| | Backup_SK_Schematic_BOM | PROC114A1(001)_BOM | XLS |
| 3_Board_File | Allegro | PROC114A1_BRD | BRD |
| | Simulation Scorecard | AM62x_Simulation_Scorecard | PDF |
| | Altium_ASCII | PROC114A1_BRD | ALG |
| 4_Gerber | ODBGBR | PROC114A1_ODBGBR | ZIP |
| | 274X | PROC114A1_274xGBR | ZIP |
| | IPC-D-356_NETLIST | PROC114A1_BRD | IPC |
| 5_Gerber_PDF | FAB | PROC114A1_FAB | PDF |
| | PCB LAYERS | PROC114A1-LAYERS | PDF |
| | Geber Layers | PROC114A1-LAYERS | PDF |
| 6_Assembly_Models_Packag e | 2D | PROC114A1_BASY | DXF |
| | | PROC114A1_TASY | DXF |
| | 3D | PROC114A1_3D_STEP | STP |
| | | IDF | PROC114A1_BRD |
| | Assembly_Drawing_PDF | PROC114A1_BRD | EMN |
| | | PROC114A1_ASSEMBLY | PDF |
| | | PROC114A1_TASY | PDF |
| | STNL | PROC114A1_BASY | PDF |
| | | art_aper + 8 x .ART 文件 | ART |
| XY-REP | PROC114A1_XY-REP | XLS | |
| 7_PCB_LAYER_STACKUP | --- | SK-AM62B_PROC114A1_Layer_STACKUP | PDF |

参考资料

德州仪器 (TI), [\[常见问题解答\] AM625/AM623 : 定制电路板硬件设计 - 关于重复使用 SK-AM62B 原理图的设计和审阅说明](#) 文章

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司